

基于 MDK 开发的 Tencentos-Tiny Software Pack Tencentos-Tiny software package based on MDK development

2021/9/3

东南大学

崔林威

https://github.com/OpenAtomFoundation/TencentOS-tiny

1、ARM 软件包介绍

1.1 软件包简介

在进行嵌入式软件开发时,ARM 为我们提供了软件包功能,能够将软件算法等模块进行集成封装,从而方便第三方用户使用。ARM 软件包能够为微控制器设备和开发板提供支持,包含软件组件(Software Component)如驱动程序和中间件,还可以包含示例项目和代码模板等,主要有以下类型的软件包:

- (1) 器件系列包(Device Family Pack): 由硅供应商或工具供应商生成,为特定的目标微控制器创建软件应用提供支持:
- (2) 板级支持包(Board Support Pack): 由电路板供应商发布,为安装在电路板上的外围硬件提供软件支持。
 - (3) CMSIS 软件包:由 ARM 提供,包括对 CMSIS 核心、DSP 和 RTOS 的支持;
- (4) 中间件包(Middleware Pack): 由芯片供应商、工具供应商或第三方创建; 通过提供对常用软件组件(如软件堆栈、特殊硬件库等)的软件集成, 从而减少开发时间;
 - (5) 内部组件 (In-house components): 由工具用户开发,用于内部或外部分发。软件组件包括以下几部分:
 - (1) 源代码、库、头文件/配置文件和文档;
 - (2) 完整的示例项目,展示了软件组件的使用,可以下载并在评估硬件上执行;
 - (3) 代码模板,方便使用软件组件。
- 一个完整的软件包是一个 ZIP 文件,包含所有需要的软件库和文件,以及一个包含软件包 所 有 信 息 的 包 描 述 文 件 (PDSC 文 件), 软 件 包 的 结 构 是 在 CMSIS 中 定 义 的 (http://www.keil.com/CMSIS/Pack)。

1.2 软件包开发

1.2.1 软件包开发过程

软件包的开发过程相当于完成了一项产品的制作,因此引入产品生命周期管理(PLM)的概念,PLM包括以下四个阶段: (1)概念的产生,基于软件包需求进行产品定义,并创建第一个功能原型; (2)设计,根据技术特征和要求,进行原型测试和产品的实施,通过广泛的测试验证产品的功能与规格; (3)发布,产品被制造出来并推向市场; (4)服务,对产品的维护,包括对客户的支持,最后不断优化,结束产品的周期。

在制作软件包时,主要面临以下几个过程:

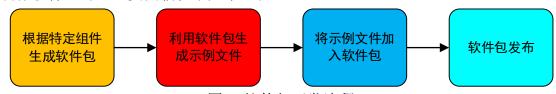


图 1 软件包开发流程

首先,根据特定组件生成软件包即根据需求将相应的头文件、库文件等软件组件利用 PDSC 文件进行组织,在组织完成后即可利用软件包生成工具生成对应版本的软件包,然后对新生成的软件包进行测试,给出示例测试程序,再将其包含如 PDSC 文件中,最后经测试完成后生成最终的软件包。

1.2.2 PDSC 文件的编写

PDSC 文件时基于可扩展标记语言(XML)进行编写的,能够将软件包包含的各个模块按

照特定的格式组织起来,接下来按照 PDSC 文件的结构对文件的编写进行详细介绍:

首先是 PDSC 文件的开头,前两句是声明为 XML 格式,它是在 MDK 中的 PACK.xsd 文件定义的,所以不用修改;<name>和<vendor>标签定义了软件包的基本内容,也用于 PACK 文件的文件名,故该 PDSC 文件应命名为 Tencent.Tencentos-tiny.pdsc;<description>标签描述了软件包的信息,它将显示在包安装程序中;<url>标签可以包含一个带有软件包下载链接的网址,方便用户下载;license>标签包含了用户使用该软件包时需要遵守的协议,<supportContact>标签表示软件包的支持人员联系方式,可以提供一个电子邮件地址或网页 URL。如图 1.1 为下列代码对应的软件包界面。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<package schemaVersion="1.0" xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
xs:noNamespaceSchemaLocation="PACK.xsd">
<name>Tencent</name>
<description>Description of your pack</description>
<vendor>Tencentos-tiny</vendor>
<url>https://github.com/OpenAtomFoundation/TencentOS-tiny</url>
license>LICENSE.txt</license>
<supportContact>...</supportContact>
```

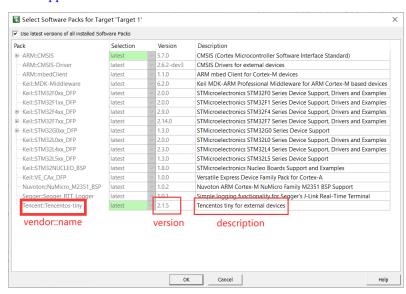


图 1.1 程序对应的软件包

接下来是 PDSC 文件的各个模块, <releases>标签定义了软件包的版本, 开发者可以在版本 更新时在此进行标注, 从而在生成软件包时, 系统会自动生成最新版本的软件包;

```
<releases>
<release version="1.0.1">
Sep/3/2021, version name
</release>
<release version="1.0.0">
Sep/1/2021, version name
</release>
</release>
```

<keywords>标签定义了软件包的关键词,在ARM官网下载软件包时可利用关键词搜索到需要的软件包。

< requirements >标签定义了软件包的关联安装需求,即在安装本软件包时,还需要在网上安装其他包(网址: MDK5 Software Packs (keil.com)),例如下面的定义则需要我们安装 ARM的 CMSIS5.7.0 软件包。

接下来是<conditions>标签,该标签在设计<components>时使用,用以说明软件包中各个组件的依赖关系,即使用本组件还需要选择其他组件。在该标签下可以定义多个 condition,每个 condition 可以定义多个条件,其中<conditions id>表示条件名,<description>为条件信息,然后便是定义的条件,其中<accept>表示该条件时可选的,当同时存在多个<accept>时,用户需要至少满足其中一个条件才可以使用;<require>表示该条件是必选的,否则便无法使用相应的组件。在条件内部,包含一些特定的指示性语法,如果在设计<component>的时候开发者选择了名为Cortex_M0 的条件,那么用户在使用该<component>时,则需要遵守条件要求:其中<accept Dvendor="ARM:82" Dname="ARMCM0"/>表示用户需要选择 ARM-Cortex M0 内核,<require condition="condition id "/>为条件嵌套,表示用户还需要满足该条件对应的要求,<require Cclass="Tencentos tiny" Cgroup="kernel" Csub="core"/>表示用户还需要选择 core 组件。

然后是<components>标签,该标签描述了软件包包含的所有文件,在编写该标签下的程序时,需要按照文件类别将文件进行划分,在下列代码中,定义了一个 Keil:: Tencentos tiny:: arch::arch 的<component>,<description>为该组件的信息,具体如下图所示。

ftware Component	Sel.	Variant	Version	Description
◆ CMSIS				Cortex Microcontroller Software Interface Components
CMSIS Driver				Unified Device Drivers compliant to CMSIS-Driver Specifications
Device				Startup, System Setup <taxonomy>description</taxonomy>
File System		MDK-Pro	6.2.0	File Access on various storage devices
Graphics		MDK-Pro	5.26.1	User Interface on graphical LCD displays
Network		MDK-Pro	6.2.0	IP Networking using Ethernet or Serial protocols
Segger Tools		Cvariant		
Tencentos tiny Cclass				
arch Cgroup			Cversion	<component>description</component>
arch Csub	~		1.0.1	arch for arm_v7m_cortex_m4_armcc
cmsis_os				
example				
◆ kernel				
USB		MDK-Pro	6.2.0	USB Communication with various device classes
mbed				

图 1.2 <component>定义界面

<components> <component Cvendor="Keil" Cclass="Tencentor")</pre>

condition="condition id"即为上述介绍的<condition>标签,从而用户在使用该组件时,还需要满足 condition 所要求的依赖组件。另外,在定义某一个<component>时,需要按照上面程序的<files>...</files>语法进行文件添加,其中 file category 的定义如表 1-1 所示,在 name 中可以添加文件路径和具体的某个文件,在软件包中,我们添加的文件默认是不可编辑的,为了方便用户对文件进行进行配置,我们需要添加 attr="config"属性,并可通过 version 更新不同版本的文件。

category	含义
doc	文件,可以是网页或者其他链接
include	包含某一个路径下的所有头文件
header	包含某路径下的具体头文件
source	.c 源文件

表 1-1 file category 定义

同时,为了使我们设计的软件包能够适配不同的内核,即在使用软件包时与用户 ARM 核不一致的文件都不出现,可以按如下步骤进行<files>的添加:(1)在 condition 条件中,加入 <require Dvendor="ARM:82" Dname="ARMCM0"/>这样的程序,该程序表示需要用户选择 ARM Cortex-M0 内核;(2)在添加<files>时,我们可以将针对不同内核,同一类型文件的 Cgroup 和 Csub 保持同样的名字,并添加上(1)中定义的 condition,这样用户选择不同内核时,将只会出现与该内核一致的文件。

另外,PDSC 文件还可以包含<devices>、<apis>、<boards>和<examples>,这些为 ARM 公司或者其他器件、开发板厂商提供,为针对器件、api 库文件、板级和相应的示例文件,具体可以参阅 ARM CMSIS 的软件包。

最后,PDSC 文件后还需要在最后加上</package>,表示该文件的结束,从而完成 PDSC 文件的编写。

1.2.3 生成软件包

在完成 PDSC 文件的编写后,为了生成最终的软件包,还需要准备如图 1.3 所示的 3 个文件,其中 PackChk.exe 用于验证软件包包含的文件是否都存在,即是否完整; gen_pack.bat 为 Windows 批处理文件,需要我们对文件中的路径进行修改,并用于生成软件包; PACK.xsd 是 schema,主要用来制定 XML 规范,用以验证我们编写的 PDSC 文件。另外,还需要准备 7-Zip File Manager 软件,用于对文件进行压缩,制作集成的软件包。

PackChk.exe	2021/7/19 22:39	应用程序	2,485 KB
gen_pack.bat	2021/9/2 14:16	Windows 批处理文件	3 KB
₽ PACK.xsd	2021/7/19 22:39	XML Schema File	85 KB



7-Zip File Manager

图 1.3 生成软件包所需的软件配置

首先利用记事本或 Notepad++打开 gen pack.bat, 对以下几个地方需要修改, 如表 1-2 所示:

SET ZIPPATH=C:\Program Files\7-Zip

SET RELEASE PATH=..\Local Release

SET PACK VENDOR=Tencent

SET PACK NAME=Tencentos-tiny

SET PACK FOLDER LIST=arch osal kernel examples

SET PACK_FILE_LIST=%PACK_VENDOR%.%PACK_NAME%.pdsc README.md LICENSE.txt

表 1-2 gen_pack.bat 修改内容

代码	含义
SET ZIPPATH	7-Zip File Manager 软件的安装路径
SET RELEASE_PATH	生成的软件包路径,为相对路径
SET PACK_VENDOR	PDSC 文件中的 <vendor>标签</vendor>
SET PACK_NAME	PDSC 文件中的 <name>标签</name>
SET PACK_FOLDER_LIST	软件包包含文件所在路径
SET PACK_FILE_LIST	README.md LICENSE.txt 所在路径

修改完毕 gen_pack.bat 后,便可以制作软件包了,首先利用 cmd 打开电脑的命令行界面,执行 cd 命令转到 gen_pack.bat 所在的路径,然后输入 gen_pack.bat 点击 enter,如图 1.4 所示,gen_pack.bat 会按照顺序压缩文件,然后读取 PDSC 文件,检查数据完整性和文件依赖是否完整,然后生成软件包,当提示 gen pack.bat completed successfully 后就完成了软件报的创建。

```
Microsoft Windows [版本 10.0.19042.1165]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\lw_cui>cd C:\Users\lw_cui\Desktop\Tencentos-Tiny\Utilities

C:\Users\lw_cui\Desktop\Tencentos-Tiny\Utilities

C:\Users\lw_cui\Desktop\Tencentos-Tiny\Utilities>gen_pack.bat

removing ...\Local_Release

Delete previous generated HTML files

Generate New HTML Files
doxygen 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。

已复制 1 个文件。
复制 1 个文件。
复制 7 57 个文件
复制 7 57 个文件
复制 7 57 个文件
复制 7 57 个文件
PackChk.exe 1.3.53 (19.07.2021 22:39)

Copyright (C) 2012-2016 ARM Ltd and ARM Germany GmbH. All rights reserved.

M362: Also suppressing Messages M502 and M504

Phase2: Static Data & Dependencies check
```

```
Phase3: RTE Model based Data & Dependencies check

Found O Error(s) and 6 Warning(s).

Creating pack file ...

Packaging complete

Removing temporary files and folders
gen_pack.bat completed successfully
```

图 1.4 软件包生成界面

此时在 Local Release 路径下,可以看到生成的软件包。



图 1.5 软件包

2、Tencentos-tiny 软件包

腾讯物联网操作系统(TencentOS tiny)是腾讯面向物联网领域开发的实时操作系统,具有低功耗,低资源占用,模块化,可裁剪等特性。TencentOS tiny 提供了最精简的 RTOS 内核,内核组件可裁剪可配置,可灵活移植到多种终端 MCU 上。而且,基于 RTOS 内核,提供了COAP/MQTT/TLS/DTLS 等常用物联网协议栈及组件,方便用户快速接入腾讯云物联网通信 IoT Hub。同时,TencentOS tiny 为物联网终端厂家提供一站式软件解决方案,方便各种物联网设备快速接入腾讯云,可支撑智慧城市、智能水表、智能家居、智能穿戴、车联网等多种行业应用。

因此,为了有效减少开发人员在移植 TencentOS tiny 到 ARM 内核单片机上的开发时间,本文基于 MDK 完成了第三方 TencentOS Tiny pack 和软件包的封装,能够使用 MDK pack 直接 生成适合不同 MCU 的 TencentOS Tiny 工程。

2.1 软件包内容

结合 TencentOS tiny 的算法架构,本文设计的软件包包括如表 2-1 所示的内容:

内	容	功能	
		包括 TencentOS-tiny\arch\arm 下内核为 Cortex-	
ar	ch	M0+、Cortex-M0、Cortex-M3、Cortex-M4、	
		Cortex-M7、Cortex-M23、Cortex-M33 的 arch 文件	
kei	rnel	包括 TencentOS-tiny\kernel 下的 core、hal 路径中的	
		文件	
cms	is_os	对应 TencentOS-tiny\osal\cmsis_os 的文件	
	helloworld_main_1.c helloworld_main_2.c	用于测试软件包的 main 文件,包括 2 个示例	
1	mcu_it.c	移植软件包时需要按照该文件对中断函数进行修改	
example	mcu_platform.h	用户可在此文件在添加对应单片机的头文件	
	tos_config 文件	对应 TencentOS-tiny\board 下的 tos_config 文件, 一种 ARM 内核对应一个 tos config 文件	

表 2-1 软件包内容

软件包具有以下功能:

- (1)软件包针对 ARMCortex-M0+、Cortex-M0、Cortex-M3、Cortex-M4、Cortex-M7、Cortex-M23 和 Cortex-M33 内核进行了 TencentOS tiny 软件的封装,用户在安装软件包后能够快速将 TencentOS tiny 相应内核的 Keil 工程中;
 - (2)软件包能够自动适应用户所选的内核,tos config和 arch 文件能够根据内核自动显示,

从而方便用户使用;

- (3)用户在勾选一个组件时,软件包会自动提示还需要勾选其他模块,并可利用界面中的 Resolve 一键勾选,防止遗漏;
- (4) 用户可自主修改对应内核的 tos_config 文件,对 TencentOS tiny 的功能进行裁剪。 2.2 软件包安装

接下来介绍 Tencent.Tencentos-tiny 软件包的安装,首先双击图 1.5 中的软件包,然后进入安装界面,如图 2.1(a),点击 I agree to all the terms of the preceding License Agreement,再点击 next 进行安装,安装完成界面如图 2.1(b)所示;

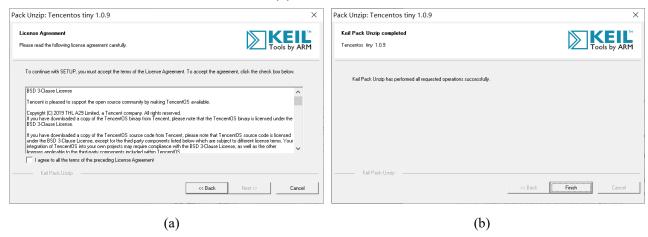


图 2.1 安装界面

此时软件包已经安装到 Keil 5 之中,打开 Keil 5 软件,并点击 Pack Installer 图标,可以进行不同软件包版本的安装与移除:

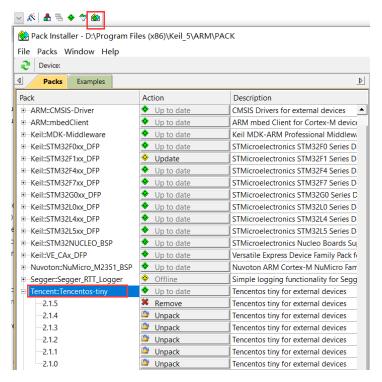


图 2.2 Pack Installer 界面

接下来就可以安装 Tencent.Tencentos-tiny 软件包中的组件,点击 Manage Run-Time Environment 图标,对需要从软件包中移植的文件进行勾选,如图 2.4 所示,如果有依赖可以点击 Resolve 进行一键安装。

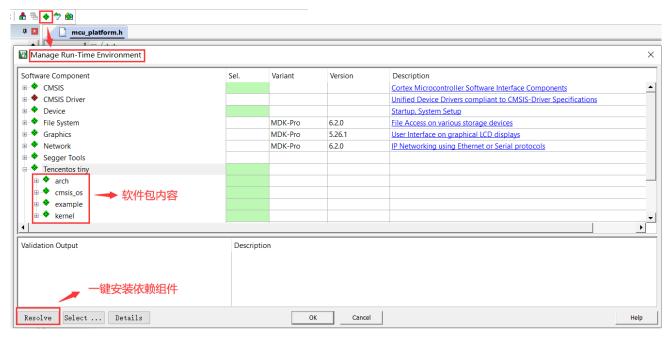


图 2.2 Manage Run-Time Environment 界面

3、软件包测试

3.1 ARM 内核移植 TencentOS tiny 软件包

首先在 MDK5 Software Packs (keil.com)下载安装 ARM CMSIS-5.8.0 软件包,以便在不同内核下测试本软件包。



图 3.1 ARM CMSIS-5.8.0 软件包

在安装完软件包后,以ARM Cortex-M3 内核为例对软件包进行移植,并进行编译,首先利用 Keil5 软件新建工程,并选择 ARMCM3,如图 3.2 所示,然后按照图 3.3 勾选相应的 Tencentostiny 组件和 Cortex-M3 内核文件,可以看到 arch 和 tos config 都已经根据内核进行了自动适配。

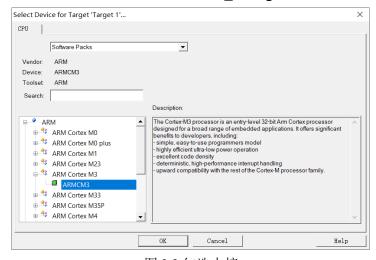


图 3.2 勾选内核

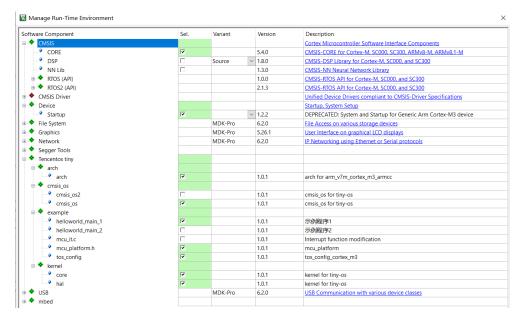


图 3.3 勾选组件

接下来点击 Options for target, 选中 Use MicroLIB。

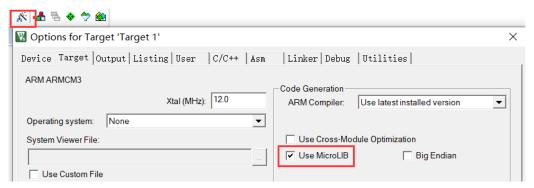


图 3.4 选中 Use MicroLIB

然后在 mcu platform.h 中添加#include "ARMCM3.h"和#include "core cm3.h"头文件。

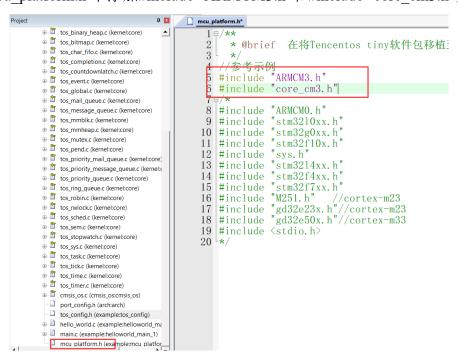


图 3.5 添加对应内核的头文件

最后点击 Build 图标进行测试,如图 3.6 所示:

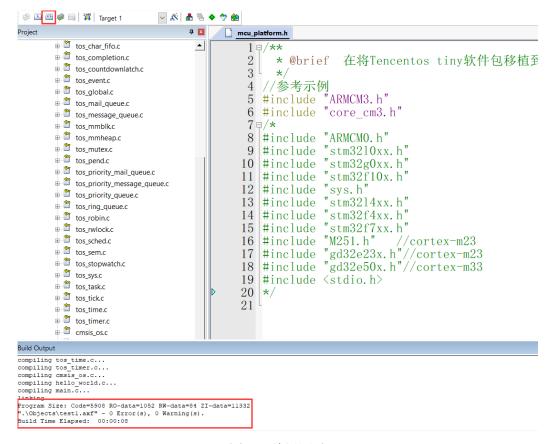


图 3.6 编译测试

与之类似,如果要在 ARM Cortex-M4 内核下对本软件包进行测试,只需要在上述步骤修改 mcu_platform.h 中的头文件为#include "ARMCM4.h"和#include "core_cm4.h"即可,如果是其他内核则对应修改头文件。

3.2 单片机开发板移植 TencentOS tiny 软件包

软件包在内核上编译完成后,接下来以正点原子探索者 STM32F407ZGT6 为例介绍 Tencentos-tiny 软件包的移植。如下图为软件包勾选的内容:

arch			
arch	~	1.0.1	arch for arm_v7m_cortex_m4_armcc
cmsis_os			
cmsis_os2		1.0.1	cmsis_os for tiny-os
cmsis_os	~	1.0.1	cmsis_os for tiny-os
example			
helloworld_main_1		1.0.1	示例程序1
helloworld_main_2		1.0.1	示例程序2
mcu_it.c	<u>~</u>	1.0.1	Interrupt function modification
mcu_platform.h	▼	1.0.1	mcu_platform
tos_config	~	1.0.1	tos_config_cortex_m4

图 3.7 软件包组件勾选

在正点原子探索者 STM32F407ZGT6 裸机工程模板中移植软件包后的界面如图 3.8 所示:

```
🗸 🗟 🥐 | @ | • · · · 🔗 🚓 | 🛅 🔻
t 🗷
                                         1 #include "stm32f4xx.h
2 #include "usart.h"
□ <sup>46</sup> Project: Template
  🖟 🗁 USER
                                           3 #include "tos_k.h"
      main.c
     stm32f4xx_it.c
      system_stm32f4xx.c
                                           6 k_task_t task1;
    CORE
    ⊕ 📮 FWLIB
                                           7 k_task_t task2;
                  裸机工程模板
    SYSTEM
                                           8 k_stack_t task_stack1[1024];
     delay.c
                                          9 k_stack_t task_stack2[1024];
      sys.c
      usart.c
                                          11 void test task1(void *Parameter)
      README
                                          12 ₽ {
       Tencentos tiny
                                          13
                                                  while (1)
      tos_cpu.c (arch:arm_v7m_cortex_m4_armcc
      tos_fault.c (arch:arm_v7m_cortex_m4_armc
port_c.c (arch:arm_v7m_cortex_m4_armcc)
                                          14 \, =
                                                       printf("task1 running\r\n");
                                          15
       port_s.S (arch:arm_v7m_cortex_m4_armcc)
                                          16
                                                       tos_task_delay(200);
      m a cmsis_os.c (cmsis_os:cmsis_os)
                                          17
      tos_barrier.c (kernel:kernel)
                                          18
      tos_binary_heap.c (kernel:kernel)
                                          19
                                             void test task2(void *Parameter)
```

图 3.8 移植界面

然后按照 mcu_it.c 对 stm32f4xx_it.c 中的 PendSV_Handler()函数和 SysTick_Handler()函数进行修改,如下图所示,注释 stm32f4xx_it.c 中的 PendSV_Handler()函数,并修改SysTick Handler()函数。

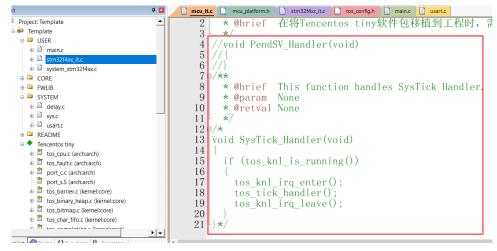


图 3.9 函数修改

接下来,使用如下 main 程序:

```
#include "stm32f4xx.h"
#include "usart.h"
#include "tos_k.h"
k_task_t task1;
k_task_t task2;
k_stack_t task_stack1[1024];
k_stack_t task_stack2[1024];
void test_task1(void *Parameter)
{
    while(1)
    {
        printf("task1 running\r\n");
}
```

```
tos_task_delay(200);
    }
}
void test task2(void *Parameter)
    k_err_t err;
    printf("task2 running\r\n");
    tos task delay(2000);
    // suspend task1 暂停
    printf("suspend task1\r\n");
    err = tos task suspend(&task1);
    if(err != K ERR NONE)
         printf("suspend task1 fail! code : %d \r\n",err);
    tos task delay(2000);
    // resume task1 恢复
    printf("resume task1\r\n");
    err = tos task resume(&task1);
    if(err != K ERR NONE)
         printf("resume task1 fail! code : %d \r\n",err);
    tos task delay(2000);
    // destroy task1 销毁
    printf("destroy task1\r\n");
    err = tos_task_destroy(&task1);
    if(err != K ERR NONE)
         printf("destroy task1 fail! code : %d \r\n",err);
    // task2 running
    while(1)
     {
         printf("task2 running\r\n");
         tos_task_delay(1000);
}
  * @brief 主函数
  * @param 无
  *@retval 无
int main(void)
    k err t err;
    /*初始化 USART 配置模式为 115200 8-N-1, 中断接收*/
    uart_init(115200);
    printf("Welcome to TencentOS tiny\r\n");
    tos_knl_init(); // TOS Tiny kernel initialize
    tos robin default timeslice config((k timeslice t)500u);
    printf("create task1\r\n");
```

然后点击编译,并利用 ST LINK-V2 将程序下载到单片机上,如图 3.10,然后将单片机的 串口与电脑连接起来,利用 XCOM 串口通讯助手进行查看,结果如图 3.11 所示。

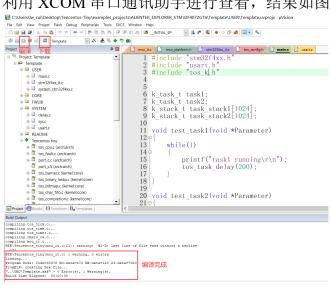


图 3.10 编译界面



图 3.11 测试界面

另外,在编译过程中如果遇到图 3.12(a)的报错,需要将图 3.12(b)中的#define TOS_CFG_OBJECT_VERIFY_EN 1u 修改为 TOS_CFG_OBJECT_VERIFY_EN 0u

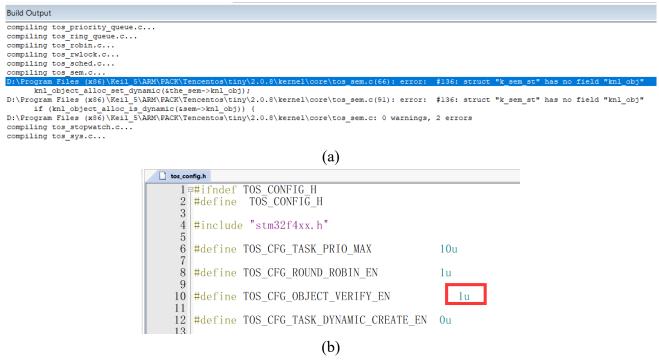


图 3.12 报错修改

4、总结

本文首先研究了基于 MDK 完成第三方软件包封装的开发过程,并编写了软件包制作的步骤,然后结合 TencentOS Tiny 物联网操作系统,对其中的 ARM 内核架构下的文件进行了封装,从而设计了基于 TencentOS Tiny 的软件包。

本软件包能够方便开发者快速地将 TencentOS Tiny 操作系统移植到用户的 ARM 内核单片机上,大大节省了开发移植的时间,同时软件包具有自动适配内核和依赖提示的功能,能够提高移植的效率。

5、开发参考

- 1、腾讯物联网操作系统网址 https://github.com/OpenAtomFoundation/TencentOS-tiny
- 2、MDK5 软件包 MDK5 Software Packs (keil.com)
- 3、制作软件包培训视频 https://www.bilibili.com/video/BV1AK411p7d9
- 4、制作软件包博客 https://blog.csdn.net/qq 40259429/article/details/119320319
- 5、制作简易软件包 https://www.cnblogs.com/libra13179/p/6273415.html
- 6、CMSIS-Driver 软件包 <u>ARM-software/CMSIS-Driver: Repository of microcontroller peripheral</u> driver implementing the CMSIS-Driver API specification (github.com)